

RFスパッタ装置 SP-31000R



RFスパッタ装置SP-31000Rは5インチから数mmのチップまで、多様な寸法のスパッタリングが可能です。ターゲットを大きくするとともに、良い膜厚分布を得る事の出来る構造になっています。1台のスパッタリング用電源で、3個のターゲットに対して自動切り換え印加が可能です、多層膜生成用に適しています。

RFスパッタ装置 SP-31000R 仕様

○到達圧力	×10 ⁻⁵ Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻⁴ Pa台迄10分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	φ540mm×250mmH
○スパッタ用電源	RF電源 13.56MHz 1kW 自動マッチング 1台
○基板形状	5インチ 1枚
○膜厚分布	±10%以内
○ターゲット寸法	6インチ(金属・絶縁物)
○ターゲット個数	3
○基板回転	無し
○基板加熱	常温～200℃迄昇温可能
○真空排気系	油回転ポンプ:900L/min メカニカルブースターポンプ:100m ³ /h クライオポンプ:1200L/sec
○操作方法	自動
○ガス系統	マスフローコントローラ 1系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相15kVA 冷却水:8L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 設置寸法:4000mmW×2000mmD×1800mmH